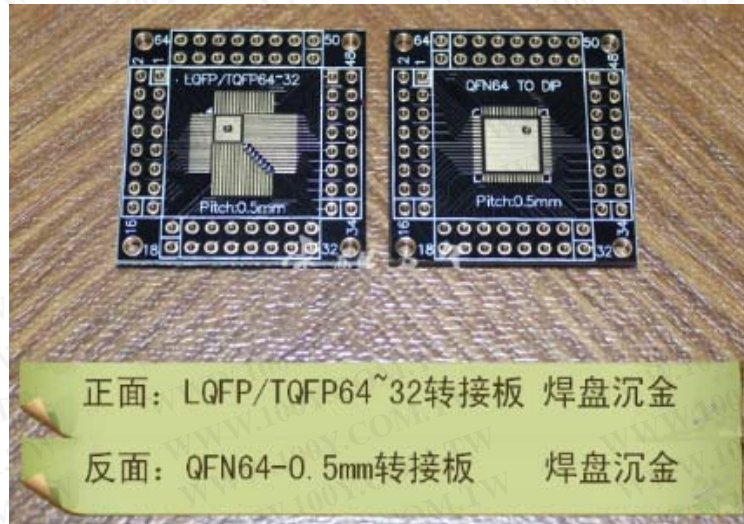


TQFP/LQFP-64-48-44-32-0.5mm

轉接板 LQFP/TQFP64,48,44TQFP32 轉 DIP/QFN64 轉 DIP 沉金

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品說明

- 1 板層: 2層板(又稱雙面板或雙層板)正面: TQFP/LQFP64~32 轉 DIP Pitch: 0.5mm, 反面: QFN64 轉 DIP Body: 9X9mm Pitch: 0.5mm
- 2 板材: FR4 板材(採用 KB 公司軍工級 A 級環保板材, 軍工品質)該板材的絕緣性, 板材的均勻性, 銅皮跟板材基材的可靠性並且銅皮不易縮水, 板材的阻抗穩定性
- 3 板厚: 1.6mm 超厚不易變形
- 4 板色: 黑油阻焊層與芯片(IC)封裝同顏色更接近芯片封裝
- 5 焊盤: 採用化學沉金工藝(即焊盤表面鍍金)焊盤與 IC 引腳接觸電阻更小、焊點更牢靠、美觀、防腐蝕、抗氧化、無鉛更環保

產品用途

本轉接板適用於以下“貼片芯片封裝”轉成插件

QFN64 轉 DIP 尺寸: Body: 9*9mm Pitch: 0.5mm 即: 焊盤間距離(引腳間距) <焊接位置: 轉接板反面>

TQFP/LQFP64 轉 DIP Pitch: 0.5mm 即: 焊盤間距離(引腳間距) <焊接位置: 轉接板正面>

TQFP/LQFP56 轉 DIP Pitch: 0.5mm 即: 焊盤間距離(引腳間距) <焊接位置: 轉接板正面>

TQFP/LQFP52 轉 DIP Pitch: 0.5mm 即: 焊盤間距離(引腳間距) <焊接位置: 轉接板正面>

TQFP/LQFP48 轉 DIP Pitch: 0.5mm 即: 焊盤間距離(引腳間距) <焊接位置: 轉接板正面>

TQFP/LQFP44 轉 DIP Pitch: 0.5mm 即: 焊盤間距離(引腳間距) <焊接位置: 轉接板正面>

TQFP/LQFP40 轉 DIP Pitch: 0.5mm 即: 焊盤間距離(引腳間距) <焊接位置: 轉接板正面>

TQFP/LQFP36 轉 DIP Pitch: 0.5mm 即: 焊盤間距離(引腳間距) <焊接位置: 轉接板正面>

TQFP/LQFP32 轉 DIP Pitch: 0.5mm 即: 焊盤間距離(引腳間距) <焊接位置: 轉接板正面>

